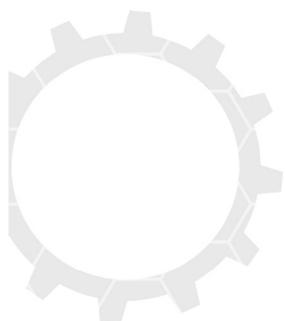


SICC
中国四联

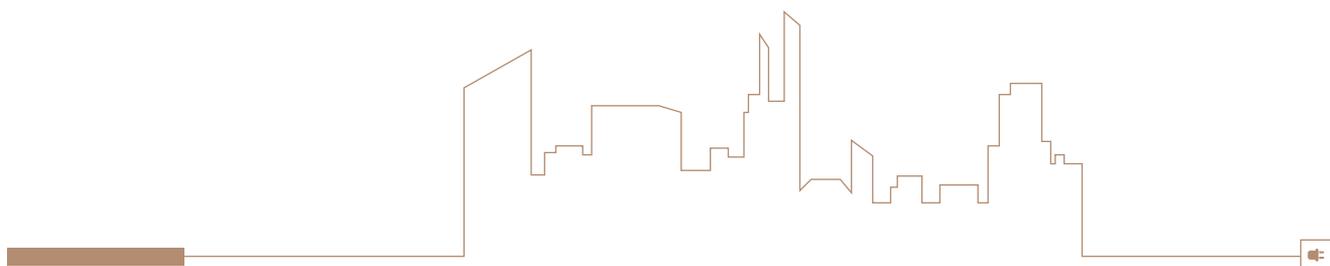
电路板（PCB）及 半导体、电子装配

四联在用户身边，用户在四联心中



重庆汇鼎电子电路有限公司

ChongqingHuiding Electronic Circuit Co., Ltd



公司简介

关于我们

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



ABOUT US

重庆汇鼎电子电路有限公司

重庆汇鼎成立于2006年，是重庆渝富控股集团下属控股公司，是专业生产电路板（PCB）及电子组装（PCBA）的高科技企业，产品广泛应用于汽车电子、仪器仪表、军工、半导体等电子领域，生产工厂分别坐落于重庆市北碚区和四川省遂宁市。聚焦高可靠性电子领域，坚持成就客户、诚信经营、开放进取，专注在可靠性领域成为一家行业领先的优秀供应商。

 公司成立
since2006 2006年

 重庆渝富集团
国企控股 下属企业

 60万m²
PCB年产能

服务领域

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



汽车电子
占比70%

Automotive electronics



仪器仪表
占比20%

Instrumentation



军工
占比5%

Military



半导体
(陶瓷基,金属基)
占比5%

semiconductor
(Ceramic-based, metal-based)

公司简介

发展历程

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



COMPANY HISTORY 公司历程



组织架构

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



公司简介

公司荣誉

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



COMPANY HONORS

2012年

- 通过ISO9001:2008质量管理体系认证

2014年

- 通过美国UL安规认证

2015年

- 通过ISO/TS16949: 2009质量管理体系认证

2016年

- 通过加拿大 C-UL安规认证

2019年

- 进入轨道交通项目领域
- 获得重庆市企业技术中心的授牌认定
- 高新技术企业
- 专精特新企业

2020年

- 通过IATF16949:2016汽车行业质量管理体系认证

2021年

- 通过质量、环境、职业健康管理体系认证

2023年

- 通过武器装备质量管理体系认证证书

2024年

- 四川汇鼎通过质量、环境、职业健康管理体系认证
- 通过IATF16949:2016质量体系认证

公司资质

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



Company Qualification

营业执照

License

国家高新技术企业

National high-tech enterprise

重庆市认定企业技术中心

Chongqing recognized as the enterprise technology center

“专精特新”企业

"Specialized, special and new" enterprises



公司简介

公司资质

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



Company Qualification

- IATF16949汽车行业质量管理体系认证证书
IATF16949 automotive industry quality management system certification
- 质量管理体系认证证书
Quality management system certification
- 环境管理体系认证证书
Environmental Management System Certification
- 职业健康安全管理体系认证证书
Occupational Health and Safety Management System Certification



专利证书

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



- 企业专利及软著 (44件)
- Enterprise patents and soft book (44 pieces)



公司简介

主要客户

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



CETC
中国电科

中国中车
CRRC

StarPower
嘉兴斯达半导体股份有限公司
StarPower Semiconductor Ltd.

MIND

晶微电子
CR MICRO

Anrui
安瑞光电
ANRU OPTOELECTRONICS

KONKA
康佳

Midea

WIPAC

瑞阳集团

ENDURANCE
耐德工业

仁寶電腦
COMPAL

重庆川仪



汽车终端客户

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



理想



吉利汽车
GEELY AUTO

NIO 蔚来



长城汽车

中国一汽

SERES
赛力斯汽车

奇瑞汽车

品质管控

品质控制

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



卓越品质的保障



品质控制团队具备深厚的行业知识、精湛的检测技术和严谨的工作态度。



设置多个重点工序及关键工序的质量控制点，通过“抓重点带一般”，实现生产线的产品监控与拦截。



通过对品质数据的统计和分析，不断优化品质控制流程和方法，持续提升产品品质。

01 品控理念

02 品控团队

03 原材料检验

04 过程监控

05 成品检验

06 持续改进

07 客户服务



“品质至上，预防为主”的理念。每一个环节都进行严格的控制和管理。



严格的供应商评估和选择机制，在原材料入库前，会进行全面的检验和测试。



检验项目涵盖外观、尺寸、性能、包装等多个方面，完全符合标准的产品才能被允许销售。



完善的客户反馈处理机制，对客户的投诉和建议进行及时、认真的处理和回复。

检验设备

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



拉力计试验机测试仪器



全自动导热系数测试仪



千分尺



铜厚测试仪



金相显微镜



双相研磨机

品质管控

检验设备

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



CCD放大镜



二次影像测量仪



德国菲希尔测厚仪



直流低电阻测试仪



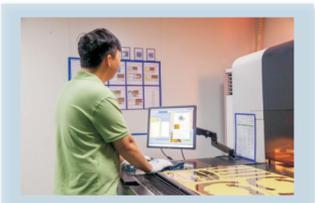
可靠性试验箱



盐雾试验机

检验设备

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



AOI检测



验孔机



电子放大镜



飞针测试仪



全自动测试仪



自动外观检测机

技术能力

制程能力

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来

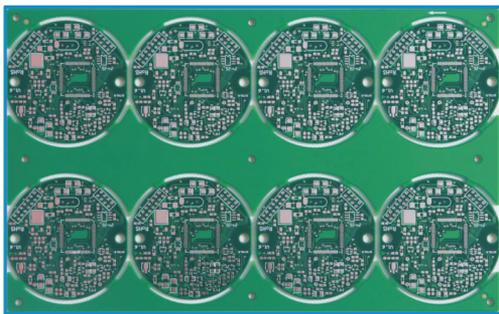


层数Number of layers	1~12层
板厚Plate thickness	0.008" ~0.16" (0.2mm~4.0mm)
最大尺寸面积 Maximum size area	400×1200mm
厚度公差 Thickness tolerances	±0.075mm
最小孔径Minimum pore size	0.20mm
最大孔径Maximum aperture size	6.0mm
NPTH孔径公差 NPTH aperture tolerance	±1mil (±0.025mm)
PTH孔径公差 PTH aperture tolerance	±2mil (±0.050mm)
铜厚Copper thickness	18um, 35um, 70um, 105um
设计线宽/间距 (最小值) (1/3OZ) Design line width/spacing (Min) (1/3OZ)	≥0.1mm (4mil)

设计线宽/间距 (最小值) (1OZ) Design line width/spacing (Min) (1/1OZ)	≥0.125mm (5mil)
设计线宽/间距 (最小值) (2OZ) Design line width/spacing (Min) (1/2OZ)	≥0.15mm (5.9mil)
表面处理Surface treatment	沉金、无铅喷锡、OSP抗氧化
镍厚Nickel thick	≥110uin
金厚Gold thick	1 uin~4uin
OSP (抗氧化) OSP (Antioxidant)	0.2-0.5um
钻孔移位公差 Drill hole displacement tolerance	±0.05mm
模具成型公差 Mold forming tolerances	±0.1mm
CNC成型公差 CNC molding tolerances	±0.10mm

主要PCB板产品

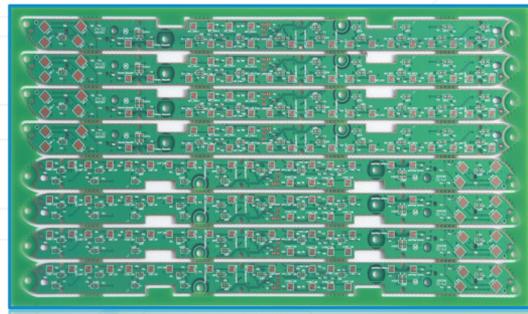
制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



应用领域：工业仪表
Application field: industrial instrument

表面处理工艺：无铅喷锡工艺
颜色：绿色
板材：TG175 FR-4
板厚：1.6mm
层数：4层
铜厚：内外层105um

Surface treatment process: lead free tin spraying process
Color: Green
Plate: tg175 FR-4
Plate thickness: 1.6mm
Number of floors: 4
Copper thickness: 105um for inner and outer layers



应用领域：汽车空调控制
Application field: Automotive air conditioning control

表面处理工艺：化学沉金
颜色：绿色
板材：FR-4
板厚：1.6mm
层数：4层
铜厚：1OZ

Surface treatment process: Chemical immersion gold
Color: Green
Plate: FR-4
Plate thickness: 1.6mm
Number of floors: 4
Copper thickness: 1oz

技术能力

主要PCB板产品

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



应用领域：车灯驱动
Application: lamp drive

表面处理工艺：无铅喷锡
颜色：白色
板材：FR-4
板厚：1.6mm
层数：4层
铜厚：20Z

Surface treatment process: lead free tin spraying
Color: white
Plate: FR-4
Plate thickness: 1.6mm
Number of floors: 4
Copper thickness: 2oz



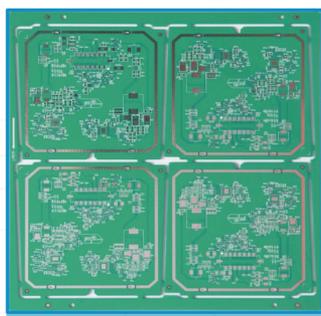
应用领域：车灯驱动
Application: lamp drive

表面处理工艺：无铅喷锡工艺
颜色：白色
板材：FR-4
板厚：1.6mm
层数：4层
铜厚：20Z

Surface treatment process: lead free tin spraying process
Color: white
Plate: FR-4
Plate thickness: 1.6mm
Number of floors: 4
Copper thickness: 2oz

主要PCB板产品

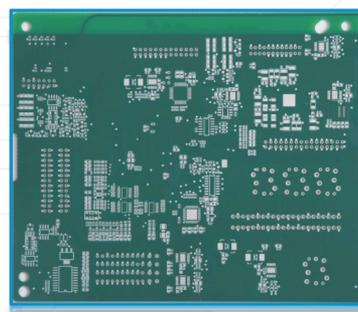
制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



应用领域：车灯驱动
Application: lamp drive

表面处理工艺：无铅喷锡工艺
颜色：绿色
板材：FR-4
板厚：1.6mm
层数：4层
铜厚：20Z

Surface treatment process: lead free tin spraying process
Color: Green
Plate: FR-4
Plate thickness: 1.6mm
Number of floors: 4
Copper thickness: 2oz



应用领域：汽车BCM
Application: Automotive BCM

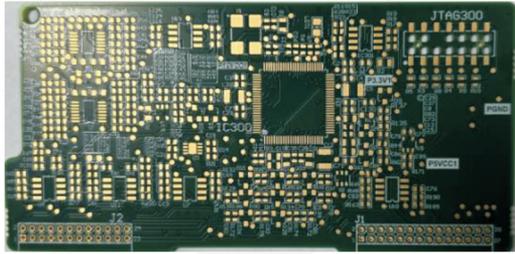
表面处理工艺：化学沉锡
颜色：哑光绿油
板材：FR-4
板厚：1.6mm
层数：4层
铜厚：10Z

Surface treatment process: chemical tin precipitation
Color: matte green oil
Plate: FR-4
Plate thickness: 1.6mm
Number of floors: 4
Copper thickness: 1oz

技术能力

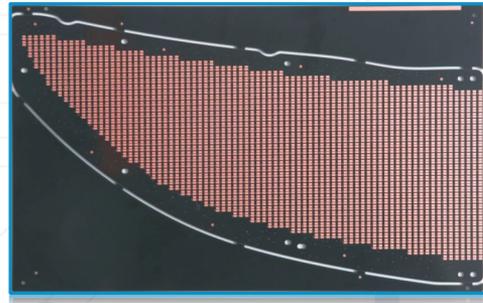
主要PCB板产品

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



应用领域：汽车电子控制单元 (ECU)
Applications: Automotive Electronic Control Units (ECUs)

表面处理工艺：化学沉金	Surface treatment process: chemical immersion gold
颜色：绿油	Color: Green oil
板材：FR-4	Plate: FR-4
板厚：1.6mm	Thickness: 1.6mm
层数：6层	Number of layers: 6 layers
铜厚：20Z	Copper thickness: 20Z

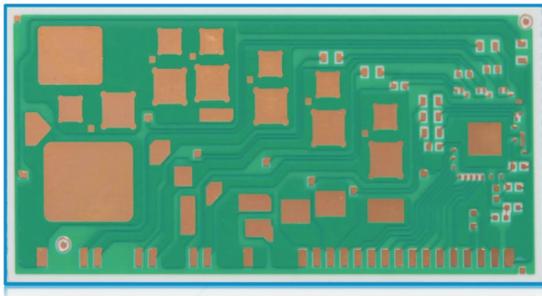


应用领域：车灯
Application: lamp

表面处理工艺：OSP	Surface treatment process: OSP
颜色：黑色	Color: Black
板材：FR-4	Plate: FR-4
板厚：1.6mm	Plate thickness: 1.6mm
层数：4层	Number of floors: 4
过孔：盲埋孔	Through hole: blind buried hole
铜厚：10Z	Copper thickness: 10Z

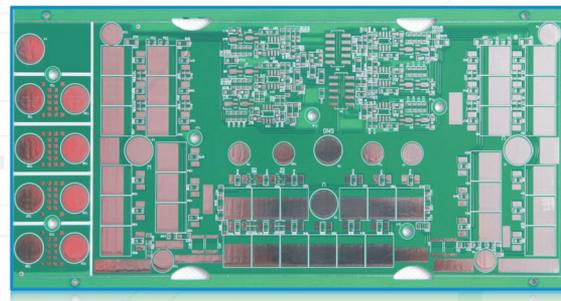
主要PCB板产品

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



应用领域：IPM半导体
Applications: IPM semiconductors

表面处理工艺：化学沉金	Surface treatment process: chemical gold precipitation
颜色：绿色	Color: Green
板材：铝基板	Plate: aluminum substrate
板厚：1.6mm	Plate thickness: 1.6mm
耐压：2KV/DC	Withstand voltage: 2kv/dc
铜厚：70um	Copper thickness: 70UM



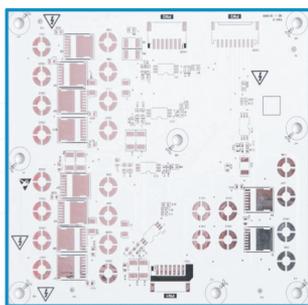
应用领域：储能
Application: energy storage

表面处理工艺：无铅喷锡	Surface Treatment Process: lead-free spray tin
颜色：绿色	Color: Green
板材：单面铝基板	Plate: single-sided aluminum substrate
板厚：1.6mm	Plate thickness: 1.6mm
层数：1层	Number of floors: 1
铜厚：30Z	Copper thickness: 30z

技术能力

主要PCB板产品

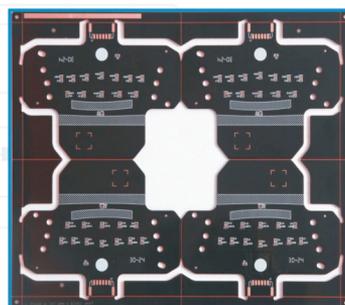
制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



应用领域：储能
Application: energy storage

表面处理工艺：无铅喷锡
颜色：白色
板材：铝基板
板厚：2.0mm
耐压：3KV/DC
铜厚：105um

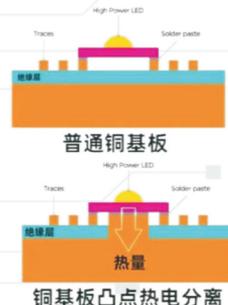
Surface Treatment Process: lead-free spraytin
Color: white
Plate: aluminum substrate
Plate thickness: 2.0mm
Withstand voltage: 3kv/dc
Copper thickness: 105um



应用领域：车灯
Application: lamp

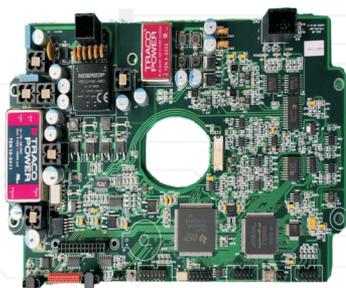
表面处理工艺：OSP
颜色：黑色
板材：铜基板
板厚：1.6mm
层数：2层
铜厚：10Z

Surface treatment process: OSP
Color: Black
Plate: Copper substrates
Plate thickness: 1.6mm
Number of floors: 2
Copper thickness: 10z



主要电子产品

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



应用领域
Application area

广泛应用于电力、冶金、化工、石油、建材、轻工、核工业等行业。
Used to measure the gas concentration of liquids, gases and vapors.

SMT

产线配备印刷机、SPI、贴片机、回流焊、AOI等设备，可以全方位满足不同产品的生产需求。
The production line is equipped with printing machine, SPI, SMT machine, reflow soldering, Aoi and other equipment, which can fully meet the production needs of different products.

DIP

插件无铅/有铅生产线，产线配备相关设备，可满足PCBA板分板、PCBA板功能检测，点胶、三防涂覆等生产要求；车间配备插件线、波峰焊，可以全方位满足不同产品型号的生产要求。
Plug-in lead-free/lead production line, equipped with relevant equipment, can meet the PCBA board sub-board, PCBA board function testing, dispensing, three anti-coating and other production requirements; workshop equipped with plug-in line, wave soldering, it can meet the production requirements of different product models in an all-round way.

生产与设备

主要生产设备

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



下料机
Blanking machine



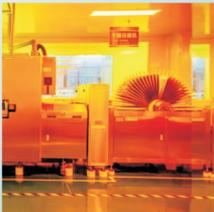
钻孔机
Drilling machine



沉铜线
Sunk copper wire



线路前处理机
Line preprocessor



干膜压膜机
Dry Film Press



LDI曝光机
LDI Exposure Machine



电镀线
Plating line



蚀刻线
Etch line

主要生产设备

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



CCD曝光机
CCD exposure machine



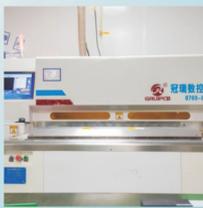
阻焊显影机
Solder mask developing machine



文字喷印机
Text printer



铣型设备
Milling type equipment



数控V-CUT机
CNC V-CUT machine



激光切割机
Laser cutting machine



OSP清洗机
OSP Washer



超声波清洗机
Ultrasonic cleaning machine

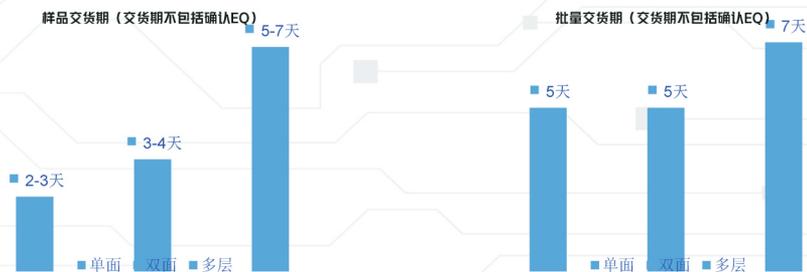
企业理念

交付能力

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



PRODUCT DELIVERY DATE



企业理念

制造精益求精 管理从严求实 服务追求满意 改进铸造未来



以客户为中心
Customer-centric



创造价值
Create value



合作共赢
Win-win cooperation



追求卓越
Strive for excellence

